



股市代號：7730

暉盛科技股份有限公司

2026 年法人說明會

核心技術、營運成果與未來發展方向

2026 年 9 月 3 日

報告人：許嘉元





公司簡介 | 以先進電漿技術驅動多元產業創新

暉盛科技股份有限公司

Nano Electronics and Micro System Technologies, Inc.

研發先進電漿技術為主軸，發展各式電漿設備，提供材料表面清潔、改質、蝕刻與鑽孔製程。



公司概況（股市代號：7730）



成立時間 | 2002 年 6 月



總部 | 台南市安南區



資本額 | NTD 3.68 億元



董事長 | 宋俊毅



總經理 | 許嘉元



核心能力



表面清潔



表面改質



電漿蝕刻



電漿鑽孔



願景與使命

願景 | 成為全球最先進、最大的電漿表面處理技術及電漿設備製造服務業者；結合智慧生產，打造最具競爭力的團隊。

長期使命 | 作為各先進產業中，長期且值得信賴的技術提供者。



關鍵應用市場



半導體



IC 載板



印刷電路板



新能源與環保

重要聲明與資訊揭露原則

本簡報依截至 2026 年 6 月 30 日已公開資訊編製



公開資訊基礎

本簡報內容依公司已公開資訊及公開財務報告編製。



歷史資料限制

歷史財務數字與過往營運表現不代表未來表現。



策略說明範圍

產業趨勢、技術方向與策略內容為公司方向性說明。



資訊揭露原則

不揭露未公開客戶、訂單、交期、內部預算或未來財務預測。

重要提示

**本簡報之策略方向與執行重點，
不構成財務預測、業績保證或
投資建議。**

實際營運可能受市場需求、客戶資本支出、
產品驗證、供應鏈、匯率及其他風險因素影響。



問答揭露原則

如涉及尚未公開之重大資訊，公司將依規定公告後再行說明。

— 今日議程

依公開資訊、技術方向與治理重點安排

1

公司定位與核心能力

電漿技術、設備整合與應用服務

2

2026 年上半年公開財務成果

已公開財報數據與結構解讀

3

產業趨勢與技術機會

半導體設備、AI 與先進封裝

4

未來策略方向

核心應用、平台化、服務與國際布局

5

投資人問答

依資訊揭露規範回應公開資訊範圍內議題

6

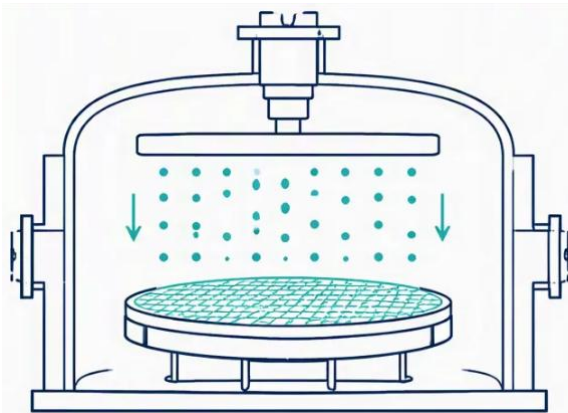
公司定位與價值主張

以電漿製程設備與整合解決方案，回應精密材料處理與量產導入需求



核心技術平台概覽

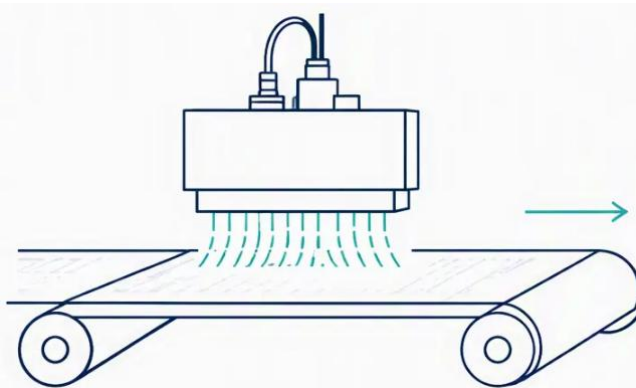
以電漿源、設備整合與應用工程支援精密材料處理



真空電漿

精密清洗、表面活化
去膠與乾式蝕刻等高潔淨度製程需求

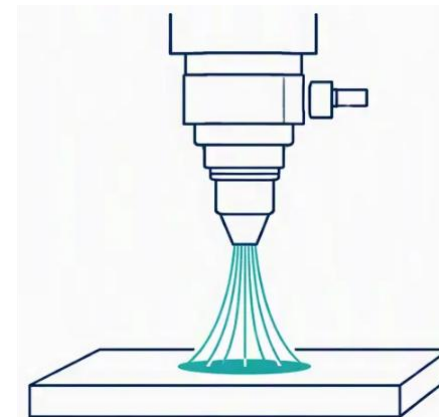
密閉腔體 | 精準控制



常壓電漿

連續式處理、線上化整合
支援材料表面清潔、改質與產線串接

連續製程 | 自動化整合



高效電漿火焰

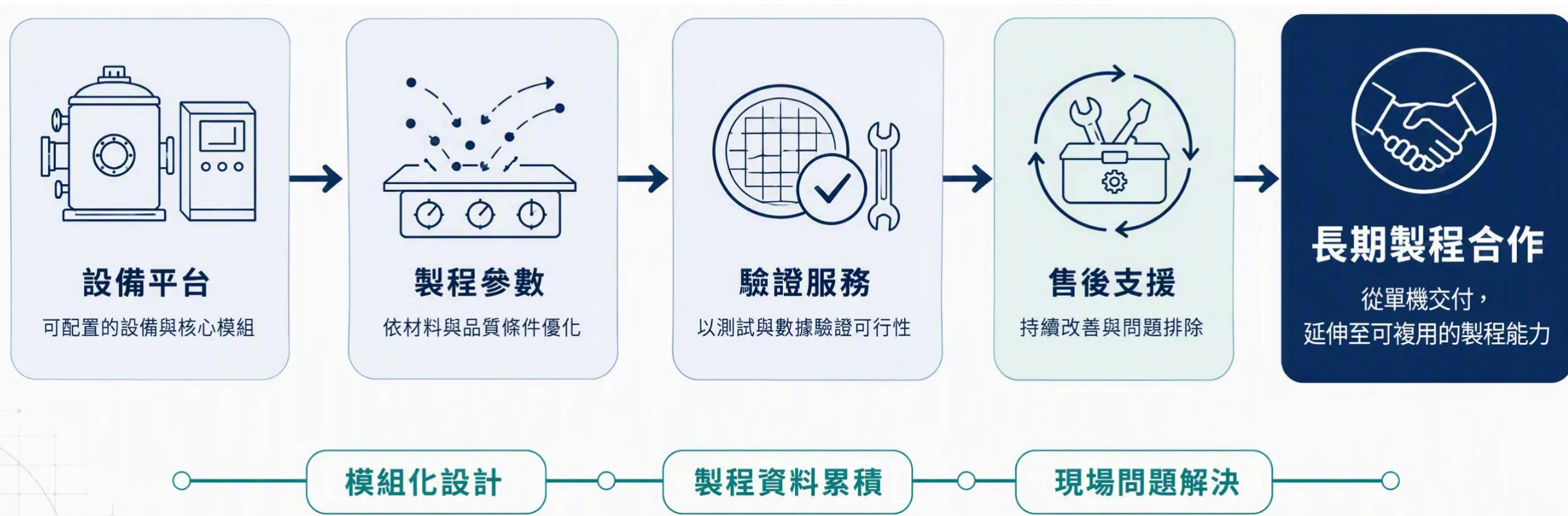
表面改質、高速處理
面向特定材料與局部處理的效率需求

局部處理 | 高效率

共同核心能力：電漿源設計 | 腔體工程 | 控制系統 | 製程參數 | 應用工程

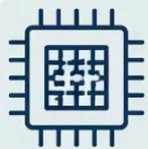
從設備供應到製程解決方案

以設備、製程與現場服務形成完整交付



應用領域與客戶價值

聚焦精密材料表面處理、製程整合與在地工程支援



半導體／先進封裝

高深寬比結構處理、去膠、表面活化、異質材料前處理。



IC 載板

提升材料潔淨度、附著可靠度與後續製程穩定性。



PCB

支援清洗、去膠渣、表面改質與自動化量產流程。



良率與可靠度

以穩定的表面處理支援品質要求。



製程重複性

以設備、參數與應用工程建立一致性。



在地工程支援

以快速問題釐清與客製化服務降低導入障礙。

2026 年上半年公開財務摘要

資料期間截至 2026 年 6 月 30 日 | 單位：新台幣百萬元, EPS 為元



營業收入
191.025
年減 25.3%



營業毛利率
45.6%
較去年同期提升約 2.1 個百分點



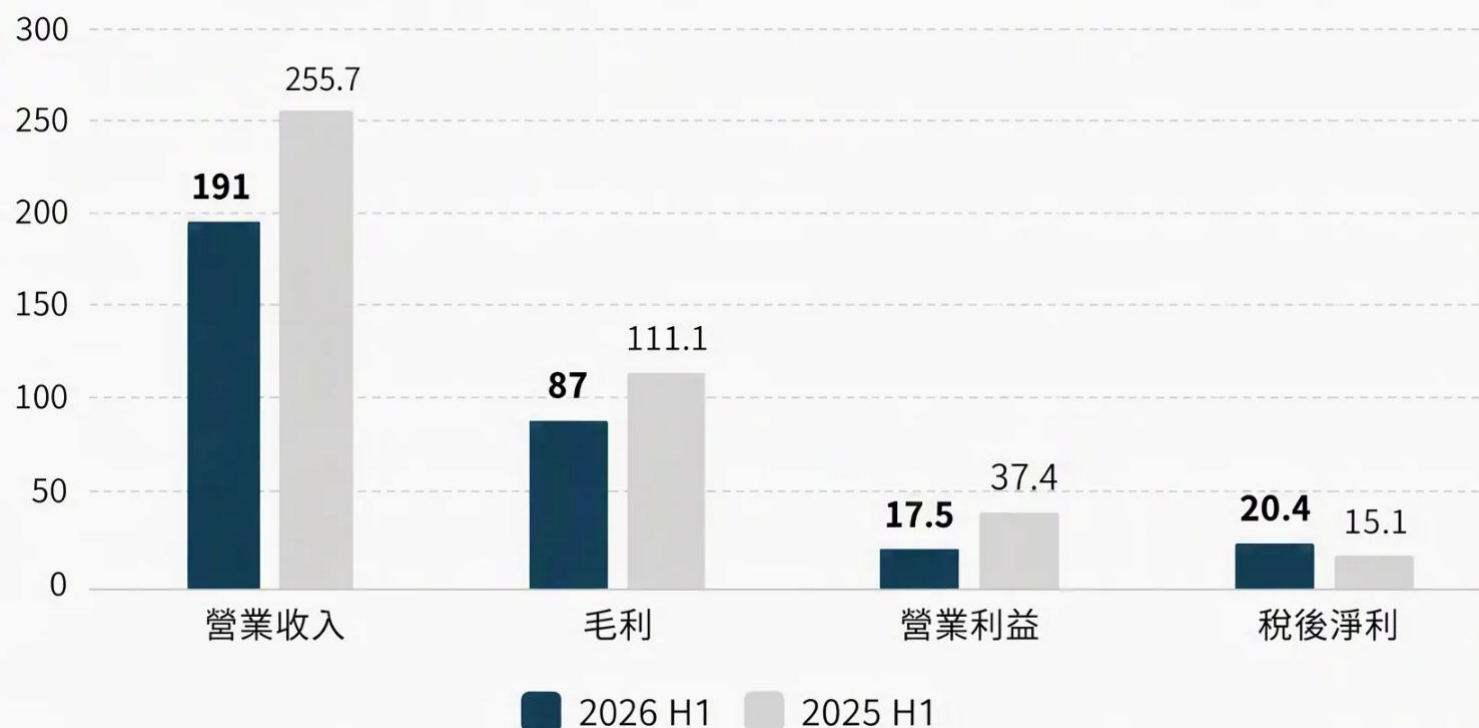
營業利益
17.503
營業利益率 9.2%



稅後淨利／基本 EPS
20.386 EPS 0.55
稅後淨利年增約 34.6%

2026 H1 與 2025 H1 損益項目比較

NT\$ 百萬元



收入規模下降，本業獲利承壓；收入組合改善帶動毛利率提升，業外轉正支撐稅後淨利。

上半年損益表重點比較

單位：新台幣百萬元 | 比較期間：2026 年上半年與 2025 年上半年

項目	2026 H1	2025 H1	年增減
營業收入	191.025	255.655	▼ 64.630 / 年減 25.3%
營業毛利	87.021	111.142	▼ 24.121 / 年減 21.7%
稅前淨利	25.473	19.101	▲ 6.372 / 年增 33.4%
稅後淨利	20.386	15.148	▲ 5.238 / 年增 34.6%

解讀重點



收入與營業毛利
較去年同期下降



稅前淨利改善，
主要反映業外損益轉正

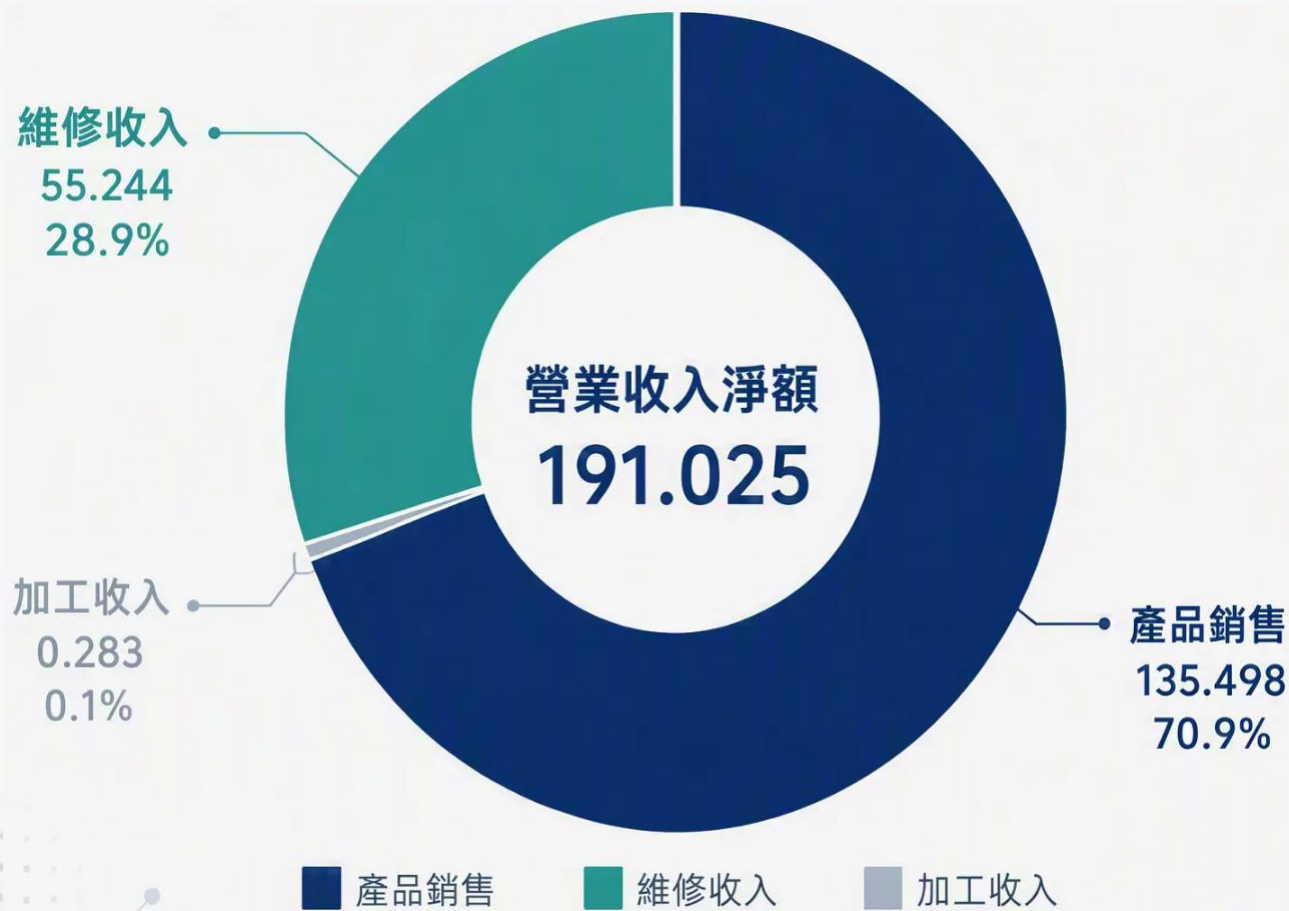


稅後淨利增加
不等同本業獲利
同步成長

資料來源：暉盛科技 2026 年第二季合併財務報告，期間截至 2026 年 6 月 30 日。

收入組合：服務收入韌性提升

2026 年上半年 | 單位：新台幣百萬元；占營業收入淨額



維修收入為收入組合的重要支撐

維修收入占營業收入約 28.9%，可在設備專案認列波動時提供較具延續性的服務收入來源。



設備收入可能受專案交付、驗收及收入認列時點影響。



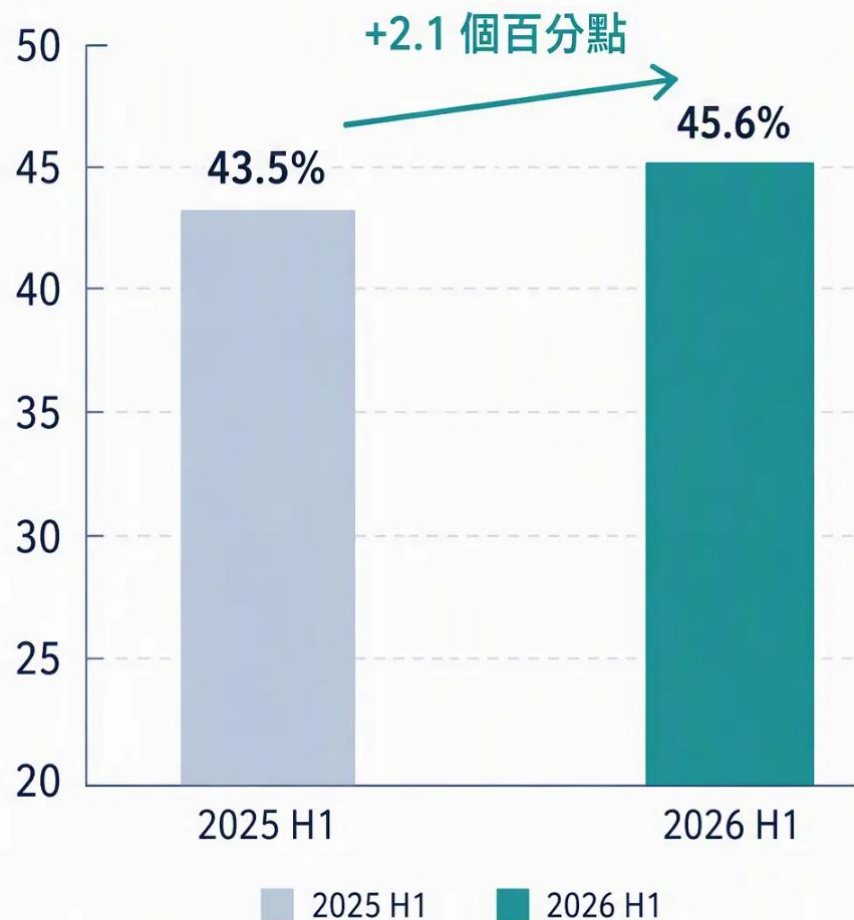
服務收入占比提升有助降低單一專案波動影響，不代表未來收入保證。

資料來源：暉盛科技 2026 年第二季合併財務報告附註六（十六），期間截至 2026 年 6 月 30 日。

— 毛利率改善因素分析

2026 年上半年與 2025 年同期比較 | 單位：% | 資料來源：2026 年第二季合併財務報告

毛利率 (%)



收入組合變化

已公開財務資料反映收入組合調整，帶動整體毛利率改善。



服務收入占比提升

維修收入占比提升，有助於提高收入組合的韌性。

— 揭露限制

-  不揭露個別產品、客戶或專案毛利
-  不提供未來毛利率目標或推估
-  毛利率表現仍受收入組合與營運條件影響

本頁僅說明已公開之歷史財務結果，不構成財務預測、業績保證或投資建議。

獲利結構：本業與業外損益解讀

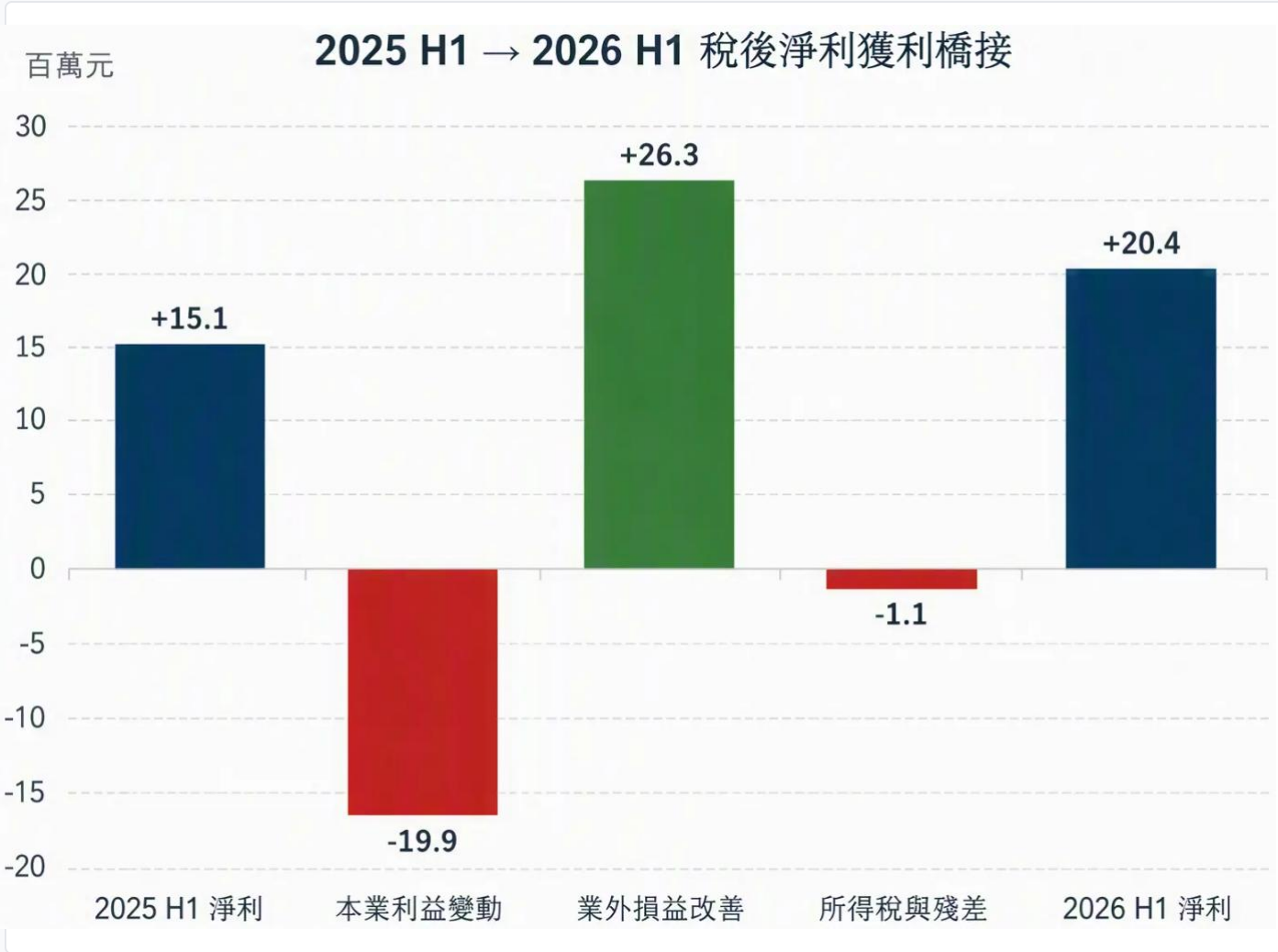
2026 年上半年與 2025 年同期比較 | 單位：新台幣百萬元

稅後淨利成長， 主要受業外損益轉正支撐

- **本業獲利下降**
營業利益由 37.438 百萬元降至 17.503 百萬元。
- **業外損益改善**
營業外收入及支出淨額由負 18.337 百萬元轉為正 7.970 百萬元。
- **稅後淨利增加**
由 15.148 百萬元增至 20.386 百萬元。

🔍 投資人宜分別觀察本業獲利能力與業外損益的持續性；
本頁僅說明已公開歷史財務結果，不構成未來財務預測。

本業壓力與業外改善共同形成本期獲利結果



資料來源：暉盛科技 2026 年第二季合併財務報告，期間截至 2026 年 6 月 30 日。

每股盈餘與股東報酬觀察

比較期間：截至 2026 年 6 月 30 日之上半年公開財務資訊



EPS 上升的主要背景



解讀重點

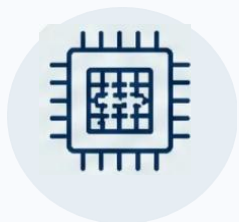
本期業外收入及支出淨額由負轉正，對稅後淨利與 EPS 具顯著影響。

EPS 成長不等同核心營業獲利同步成長，應併同觀察本業與業外損益。

應用領域與市場成長動能

聚焦高成長應用市場，以電漿製程、設備整合與在地工程支援切入

主要市場 CAGR 展望



半導體／先進封裝

高深寬比結構處理、去膠、表面活化、異質材料前處理。

先進封裝應用延伸

- ① 面板級封裝 (FOPLP / PLP)
- ② 晶圓級與其他先進封裝 (FOWLP / Wafer-Level Packaging)
- ③ 玻璃基板封裝 (Glass Substrate / Core / TGV)



IC 載板

提升材料潔淨度、附著可靠度與後續製程穩定性。



PCB

支援清洗、去膠渣、表面改質與自動化量產流程。

IC 載板

9.4%

CAGR | 2025-2033

先進 IC 載板市場

Grand View Research

先進封裝

23%

CAGR | 2024-2030

高階效能封裝 (2.5D / 3D 等)

Yole Intelligence / SEMI

PCB 高成長應用

AI 伺服器 PCB

16.5%

CAGR | 2024-2029

CIC / 港交所公開文件

光收發模組

11.1%

CAGR | 2026-2033

Grand View Research

註：以上為外部市場研究機構之產業預估，不代表輝盛科技營收、接單、市占率或業績預測。



良率與可靠度

以穩定的表面處理支援品質要求。



製程重複性

以設備、參數與應用工程建立一致性。

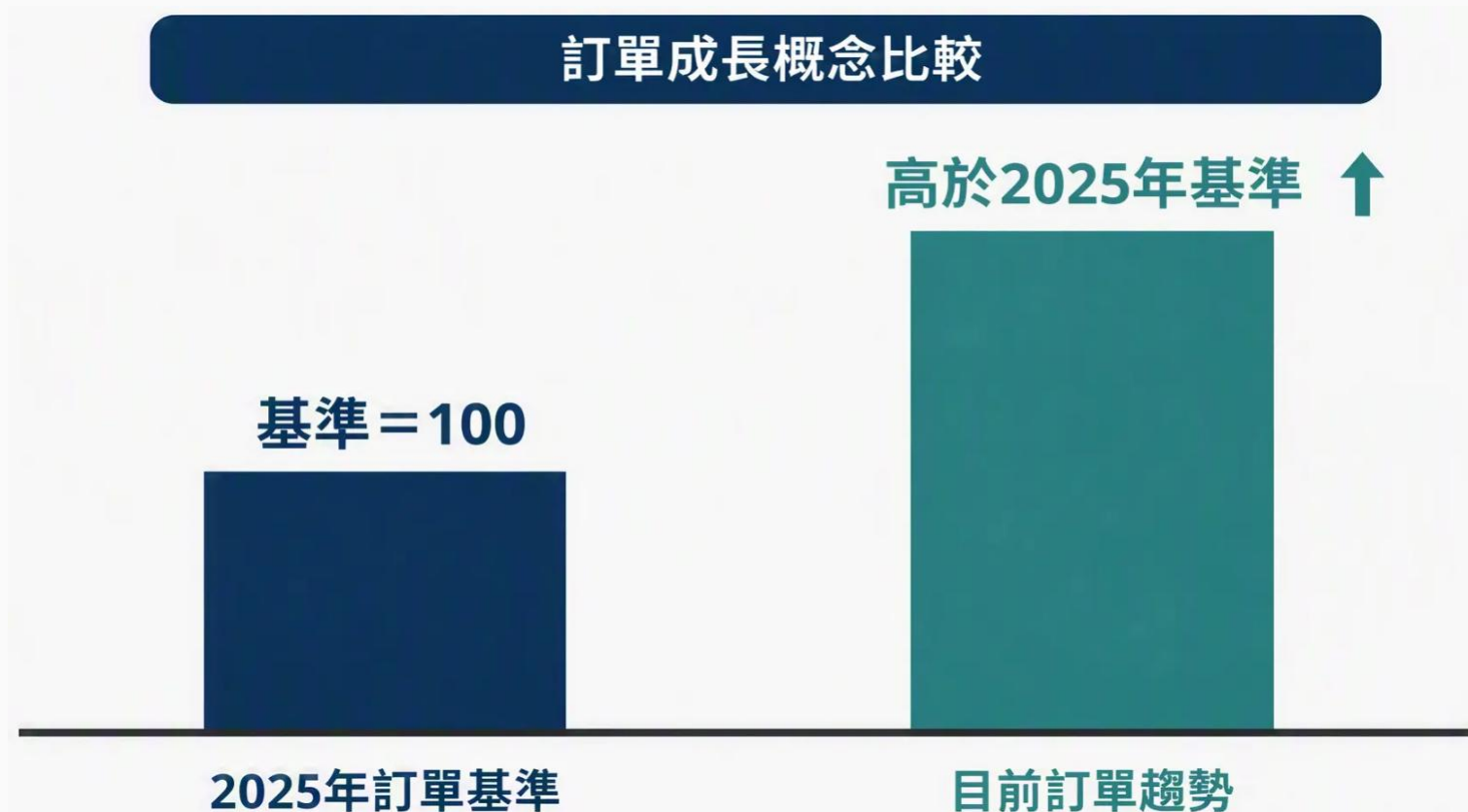


在地工程支援

以快速問題釐清與客製化服務降低導入障礙。

截至 2026/7/30 訂單成長趨勢 (概念性比較)

以2025年訂單基準觀察目前訂單動能



口徑必須清楚

- 訂單基礎持續累積
- 新增案件動能提升
- 訂單不等同已認列營收
- 實際收入仍取決於履約、驗收及適用會計準則

⚠ 本頁以概念性趨勢比較呈現訂單動能，不揭露訂單金額或財務預測；資料如有變動，應依規定同步更新。

管理接單的產業分布

管理訂單產業分布 | 資料截至 2026/7/30



結構解讀

- ① IC載板為目前主要觀察來源
- ② 先進製程／封裝形成應用拓展方向
- ③ PCB與其他應用有助於產業組合多元化

產業分布依公司核准之管理訂單口徑彙整，不代表已認列營收、未來營收或業績承諾；實際營收依個別合約、履約進度及適用會計準則辦理。

接單狀態與履約觀察

以案件狀態與商業化節點呈現能見度

正式採購訂單 (PO)

以已取得正式採購文件之案件
進行交付、安裝與驗收管理

意向書 (LOI)

屬合作意向或規劃資訊，
不代表確定承諾、正式訂單
或已實現營收

管理中案件

須完成商務條件、客戶確認與
內部核准，未達正式狀態前
不列為已實現成果

規格確認



交付準備



安裝／驗收



符合收入認列條件

投資人觀察重點

正式文件狀態

交付與驗收節點

收入認列條件

接單不等同營點；實際收入仍取決於正式文件、履約進度、驗收結果及適用會計準則。

本頁不揭露未公開之接單金額、客戶名稱或預測數字；相關資訊如依法應公告，將於完成公開揭露後再行說明。

2026 全年月營收：1-7月實績與後續認列可能趨勢

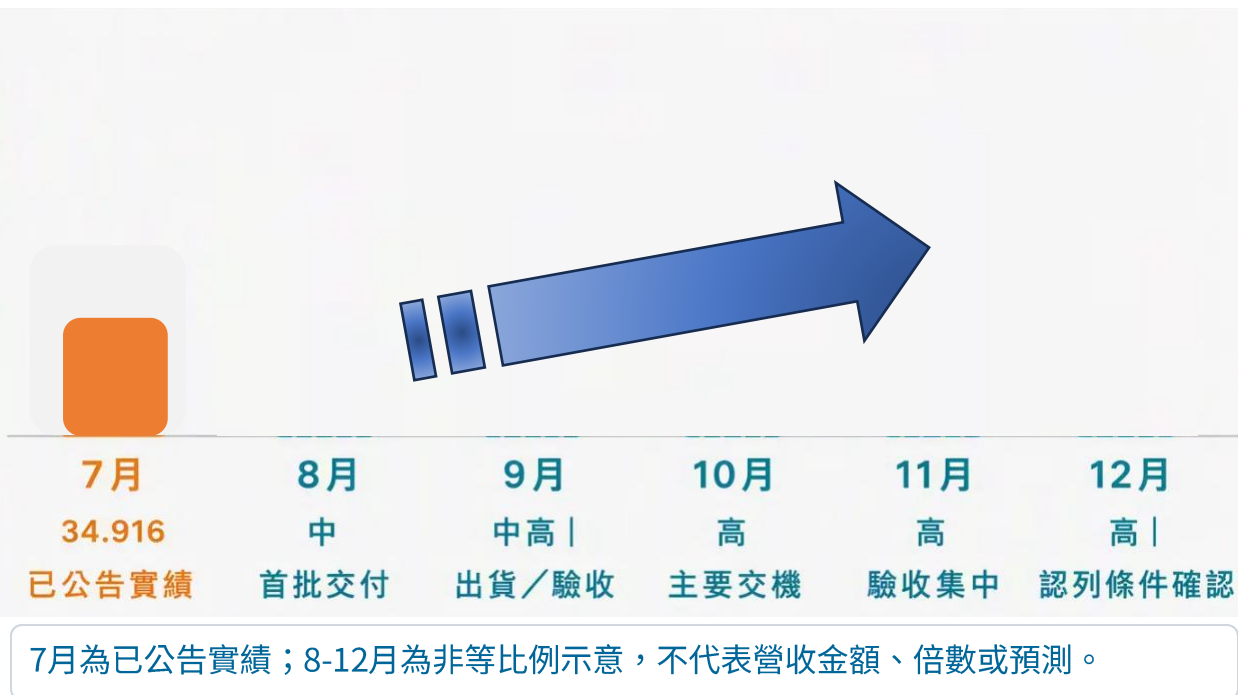
1-7月為公司已公告月營收 | 8-12月僅呈現相對認列強度，不揭露預估金額

2026 H1 | 已公告實際營收 (NT\$M)



橘色實心 = 7月已公告實績

2026 H2 | 7月實績與8-12月相對認列節點

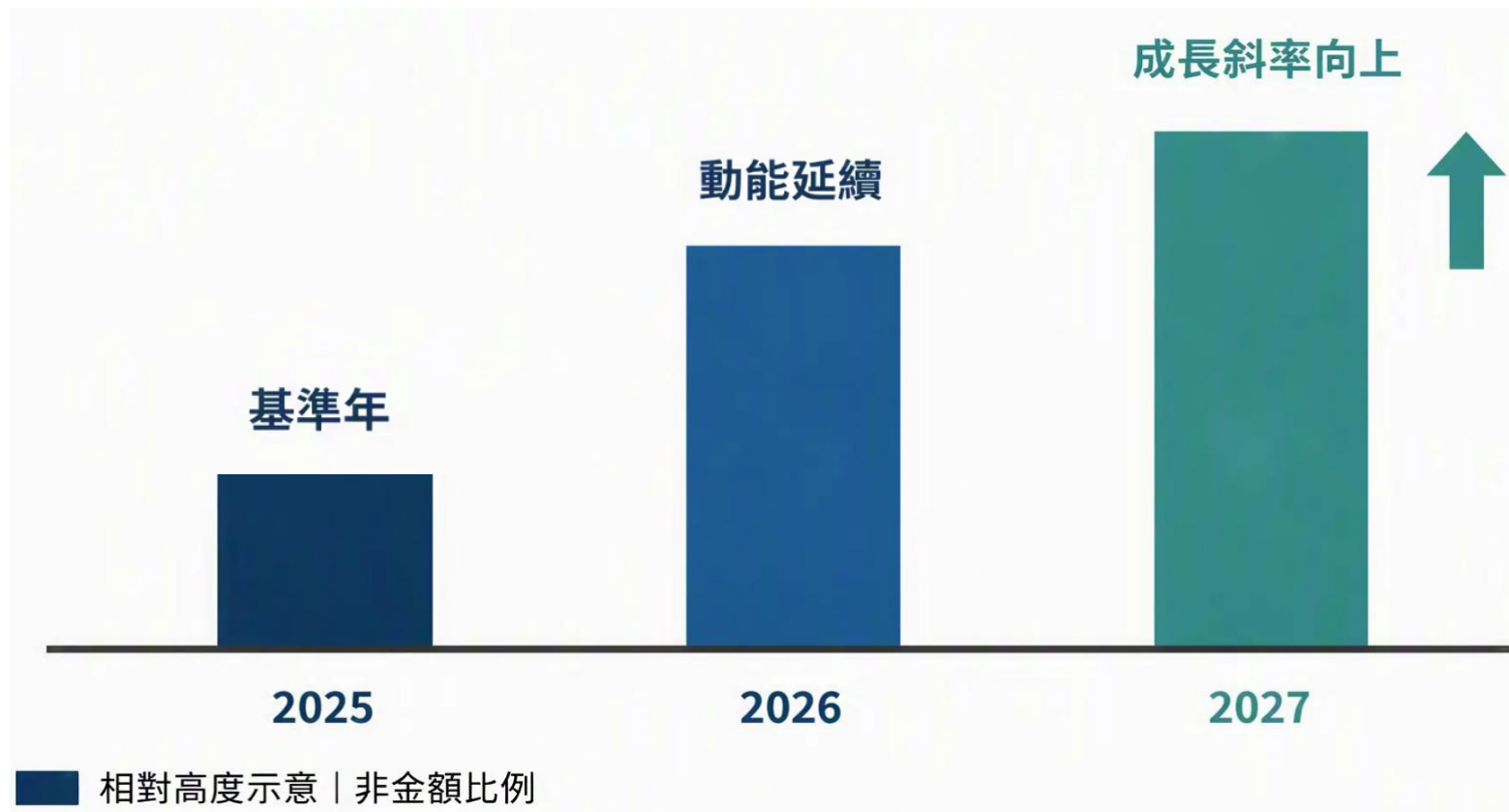


設備完成 / 出貨準備 → 客戶現場安裝 → 客戶驗收 → 符合會計收入認列條件

本頁 1-7月僅呈現已公告實際營收；8-12月僅呈現專案節點及相對認列強度，不構成營收預測、預估金額或業績保證。實際收入以公司依法公告之財務報告及月營收資訊為準。
來源：暉盛科技官網及公開資訊觀測站 2026 年 1-7月營收公告；內部專案管理資料截至 2026/7/30。

設備訂單成長斜率（概念性比較）

以2025年設備訂單基準觀察2026-2027動能



法人閱讀重點

- ❶ 2025年作為比較基準，觀察設備訂單動能變化
- ❷ 2026年動能延續，產品組合逐步轉向高階應用
- ❸ 2027年成長斜率向上，反映公司對設備平台化與量產導入的規劃
- ❹ 實際訂單仍取決於客戶驗證、預算、交期與驗收條件

本頁以相對長度呈現設備訂單動能，不揭露訂單金額，不代表營收、獲利或業績預測；
2026-2027為公司規劃與機會情境，實際結果仍受市場與執行進度影響。

H2-2027 接單產業組合：核心仍在，第二曲線加速

以百分比區間呈現管理能見度與規劃方向



依截至 2026/7/30 管理接單產業結構轉為區間呈現



依內部年度營業計畫之產業組合轉為區間呈現



成長動能來自產業組合由單一核心，逐步走向核心 + 先進封裝 + PCB 的多支柱結構。

本頁百分比區間為管理能見度與規劃情境，不代表實際接單金額、營收、獲利或業績預測；實際產業組合仍取決於 PO/LOI 狀態、客戶驗證、市場需求與交付條件。
資料截至 2026/7/30；法說會使用前須完成公司內部核准及依法應辦之公開資訊申報，資料狀態如有變動應同步更新。

2026-2027 設備訂單機型分布

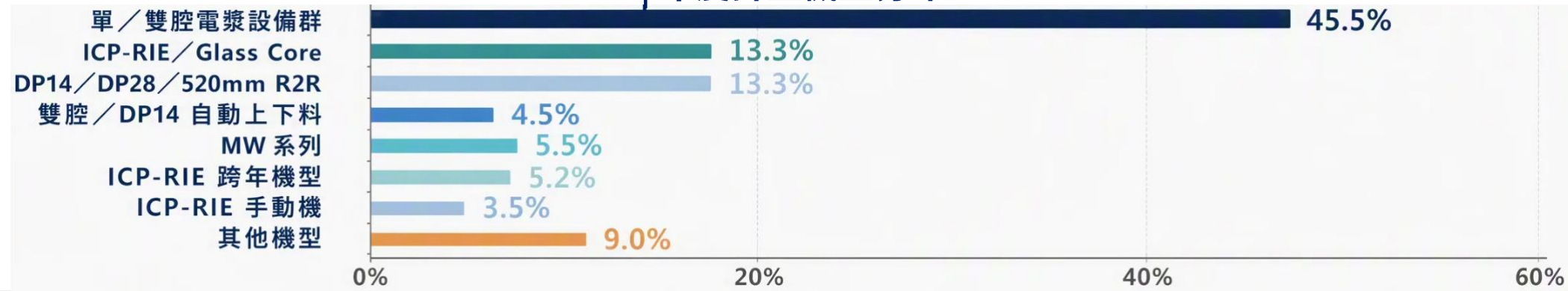
依設備訂單金額占比呈現 | 不列金額 | 2027依最新核准年度計畫完整展開

2026 | 管理接單機型分布

資料截至 2026/7/30



2027 | 年度計畫機型分布



 2027 前三大機型群合計 72.1%

 2027 前五大具名機型群 82.9%

核心機型仍具規模效益；自動上下料、MW、跨年與手動機型的展開，顯示產品平台逐步多元化。

註：本頁百分比依設備訂單金額計算，不揭露金額；各機型占比為四捨五入值，前三大72.1%與前五大具名機型群82.9%係依未四捨五入原始金額計算；「其他機型」為低量機型合併項，不納入前五大具名機型群計算。本頁不構成營收、獲利或業績保證。

技術發展使命

以市場與先進封裝製程需求為起點，建立可量產的新設備、新製程與關鍵電漿技術；
由技術驗證、設備商品化到供應鏈導入，逐步形成可複製的技術資產。



1 | 先進封裝表面活化

TCB、Hybrid Bonding、Fluxless 接合前處理



2 | 高密度電漿清潔

先進封裝Underfill 前間隙清潔技術、ABF鑽孔



3 | 300 mm 精密晶圓製程

e-chuck、低 SSD 與 OES EPD



4 | 面板／玻璃基板設備

Panel ICP-RIE、Glass Core、TGV



5 | DRIE／ICP-RIE 精密蝕刻

ABF 微孔、Si／SiC、終點偵測與溫控

成功關鍵

量產驗證完成

設備平台商品化

製程數據資產化

國際供應鏈導入

2026-2027 技術商品化路線圖

由單點製程驗證，逐步走向模組化設備、量產規格與供應鏈導入



核心發展邏輯 | 製程能力 → 設備平台 → 量產驗證 → 供應鏈導入



量產驗證

驗證長時間穩定性與製程一致性



設備商品化

建立可複製、可整合的設備平台

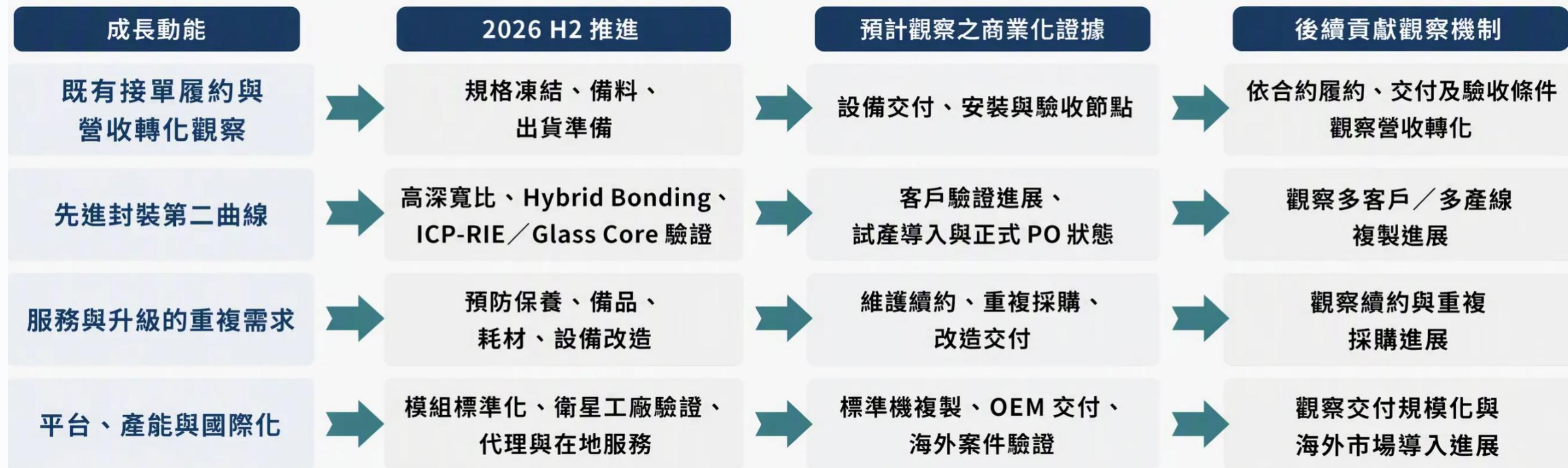


國際供應鏈導入

推動合格認證與海外應用拓展

2026 H2-2027 成長動能橋接：從案件基礎走向商業化證據

法人可追蹤的不只是策略，而是驗證、訂單、交付、驗收與重複收入的推進



法人後續可觀察的五個成長訊號

PO／LOI 階段進展	規格凍結	交付與驗收	驗證與正式訂單狀態	維護續約與重複採購
-------------	------	-------	-----------	-----------

成長不是由策略文字產生，而是由案件跨越驗證、訂單、交付、驗收與重複採購後逐步形成。

衛星工廠協同製造：以分工治理建立交付彈性

核心技術與關鍵品質由暉盛科技掌握，成熟作業由合格夥伴執行

01 定義與授權

公司主責

- 核心設計與關鍵製程
- 軟體、料件與品質規範

夥伴執行

- 能力盤點與製程建置

資格審查／規格核准

02 協同製造與驗證

公司主責

- 首台認證與性能判定
- 技術問題與客戶介面

夥伴執行

- 標準化組裝、配線與模組測試

首件認證／小批量驗證／放量評估

03 量產治理與追溯

公司主責

- 品質放行與工程變更
- 重大異常決策

夥伴執行

- 依核准版本生產
- 序號、批次與測試紀錄

變更管制／全程追溯／定期稽核

責任明確 | 品質受控 | 變更受控 | 資料可追溯

本頁為產能與治理策略，不構成產能、出貨、成本或財務效益預測。

結語與 Q&A

以公開資訊、專案里程碑與營運治理持續溝通

已公開實績

2026 H1 營收承壓，毛利率改善；業外損益轉正支持稅後損益與每股盈餘表現。

接單基礎

管理訂單以已確認訂單與新增管理案件分層呈現。

下半年觀察

收入認列取決於設備完成、出貨、安裝、客戶驗收與會計認列條件。

中長期動能

核心應用、先進封裝、服務升級、平台化、產能韌性與國際化持續推進。

Q&A | 歡迎提問

公司將依公開資訊揭露規範回應。

涉及未公開重大資訊、客戶／訂單細節或財務預測之問題，公司將依規定於公開資訊觀測站揭露；現階段不提供個案或未公開量化資訊。